

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】 第 7 部門第 2 区分
【発行日】 令和 7 年 3 月 24 日 (2025.3.24)

【国際公開番号】 WO2024/014152
【出願番号】 特願 2024-533553 (P2024-533553)
【国際特許分類】
H 0 1 L 2 1 / 0 2 7 (2 0 0 6 . 0 1)
B 2 9 C 5 9 / 0 2 (2 0 0 6 . 0 1)
【 F I 】
H 0 1 L 2 1 / 3 0 5 0 2 D
B 2 9 C 5 9 / 0 2 B

10

【手続補正書】
【提出日】 令和 6 年 11 月 6 日 (2024.11.6)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】 特許請求の範囲
【補正対象項目名】 全文
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項 1】

20

パターン基材の製造方法であって、

基材と、前記基材上に形成された硬化層からなり凹部及び凸部を有する前駆パターンマスクと、を有する硬化層複合体における前記前駆パターンマスクを第 1 除去液により処理して少なくとも前記凹部の硬化層の厚さに相当する前記硬化層を除去し、該凹部に位置する前記基材が露出した所定のパターンマスクを有するレジスト複合体を得る第 1 除去工程 (A) と、

前記レジスト複合体に対して前記所定のパターンマスクを介して表層処理を施し、処理表層複合体を得る表層処理工程 (B) と、

30

前記処理表層複合体の前記所定のパターンマスクを第 2 除去液により除去し、パターン基材を得る第 2 除去工程 (C) と、を含み、

前記第 1 除去工程 (A) における除去条件と前記第 2 除去工程 (C) における除去条件が異なる、パターン基材の製造方法。

【請求項 2】

前記表層処理工程 (B) が、前記所定のパターンマスクを介して露出した前記基材のエッチングを行い、前記処理表層複合体を得るエッチング工程である、請求項 1 に記載のパターン基材の製造方法。

【請求項 3】

前記表層処理工程 (B) が、前記所定のパターンマスクを構成する前記硬化層とは異なる材料を前記レジスト複合体の表面に配置し、前記所定のパターンマスクを介して前記基材上に前記異なる材料からなる材料層を設けた前記処理表層複合体を得る異種材料配置工程である、請求項 1 に記載のパターン基材の製造方法。

40

【請求項 4】

前記第 1 除去液の組成と前記第 2 除去液の組成とが異なる、請求項 1 に記載のパターン基材の製造方法。

【請求項 5】

前記第 1 除去液の温度が前記第 2 除去液の温度より低い、請求項 1 に記載のパターン基材の製造方法。

【請求項 6】

50

前記第 1 除去工程（A）における前記硬化層の除去時間が前記第 2 除去工程（C）における前記硬化層の除去時間より短い、請求項 1 に記載のパターン基材の製造方法。

【請求項 7】

前記前駆パターンマスクが、インプリント成型物である、請求項 1 に記載のパターン基材の製造方法。

【請求項 8】

前記工程（A）～（C）をロールツーロールプロセスで行う、請求項 1 に記載のパターン基材の製造方法。

【請求項 9】

前記硬化層複合体の前記硬化層が、単官能モノマーをモノマー成分中 95 質量%以上含有する硬化性組成物の硬化物である、請求項 1 に記載のパターン基材の製造方法。

【請求項 10】

モノマーと、

重合開始剤と、を含有し、

前記モノマーは、単官能モノマーを含み、

前記単官能モノマーの含有量が前記モノマー成分中 95 質量%以上である、請求項 1 ～ 9 のいずれか一項に記載のパターン基材の製造方法に用いる硬化性組成物。

【請求項 11】

パターン基材を用いた部品の製造方法であって、

前記パターン基材を請求項 1 ～ 9 のいずれか一項に記載のパターン基材の製造方法を用いて製造した、部品の製造方法。

10

20

30

40

50